



## Автоматическая установка монтажа шариков припоя SB<sup>2</sup>-Jet

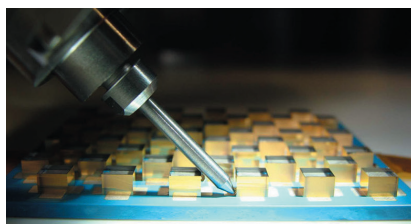


Флагманская платформа RasTech для бесконтактного монтажа шариков припоя, бампинга и лазерной пайки. SB<sup>2</sup>-Jet с высокоточными приводами – самая современная и передовая установка автоматического высокоскоростного последовательного монтажа и лазерного оплавления шариков припоя. Благодаря высокой точности и надежности, оборудование зарекомендовало себя в серийном производстве. Большое рабочее поле позволяет использовать SB<sup>2</sup>-Jet для широкого круга задач. Полная версия этого оборудования оснащена автоматической системой распознавания образов, системой 2D-инспекции, а также ремонтным блоком, выполняющим функцию реболлинга. Опционально SB<sup>2</sup>-Jet оснащается автоматической станцией для загрузки/выгрузки пластин или подложек. Станция может быть выполнена на основе конвейера, робота или системы подачи с катушки на катушку (reel to reel). Установка SB<sup>2</sup>-Jet может быть встроена в автоматизированную конвейерную линию.



### Основные возможности:

- Бесконтактный монтаж шариков припоя
- Материалы припоя – SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi
- Бесфлюсовая пайка методом лазерного оплавления
- Диаметр шариков припоя от 40 до 760 мкм
- Функция ремонта (снятие шариков и реболлинг)
- Встраивание в линию



### Возможные применения:

- Бампинг пластин или одиночных кристаллов
- Корпусирование на уровне пластин (Wafer Level CSP)
- Монтаж шариков припоя на корпуса BGA / CLCC, реболлинг
- Бесконтактная лазерная пайка компонентов на печатных платах
- Корпусирование MEMS и компонентов по технологии 3D
- Производство жестких дисков (HGA, HSA, Hook-Up, Spindle-motor)
- Сборка видеокамер, CMOS-датчиков
- Сборка изделий оптоэлектроники и микрооптических приборов
- Производство фильтров (SAW, BAW, F-BAR)

Параметры	SB <sup>2</sup> -JET
Габариты / Рабочая зона	1262 x 987 x 1845 мм / 320 x 320 мм
Скорость и точность монтажа шариков	6–8 шар/сек; ± 3–5 мкм, 1 σ
Диаметр шариков	≥ 40 мкм
Рабочая станция	Стол для пластин, матричный поддон
Автоматизация	Держатель и транспортировщик пластин, встроенный конвейер, JEDEC поддон и пр.
Лазерная ручная центровка / Лазерная автоматическая центровка	Нет / Есть (3D)
Распознавание образов	Есть
2D / 3D пайка	Есть / Есть
Ремонт	Опция
Виды изделий	Части пластин, пластины диаметром до 12", подложки, одиночные кристаллы, корпуса BGA, CSP, видеокамеры, HGA, HSA и др.

ООО «ЛионТех-С»  
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

**8 800 555 6889**

**8 (812) 309-27-37**

**8 (495) 646-14-76**

**www.liontech.ru**

*Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники*